

## 氢氟酸气相腐蚀机 (MHFF-01AR)

设备编号为 MHFF-01AR 的氢氟酸气相腐蚀机是微构龙科技(MST)专门为半导体和 MEMS 领域设计和制造的, 适合高等院校和研发单位进行 6inch 及以下样片的 MEMS RELEASE 工艺的研发和小批量生产使用。同时也适合硅片金属化工艺的优化和提升。



### 设备技术指标和功能描述

1	主体材料	德国进口劳士领瓷白 PP 材料。
2	腔体材料	德国进口劳士领瓷白 PP 材料。
3	腔体结构	圆形, 直径 200mm。
4	腔体上盖	德国进口劳士领瓷白 PP 材料, 带 PC 透视窗, 氟胶密封圈密封。
5	载片盘	适合 6INCH 及以下尺寸任何形状的硅片操作。
6	旋转装置	驱动载片盘旋转, 转速 0-30rpm 可调。
7	源瓶系统	PP 双源瓶系统。选配: 源瓶温度控制系统, 控制范围 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 。



8	流量控制	电磁阀控制浮子流量计，分别控制氢氟酸携带流量和腔体充气清洗流量。
9	双排风	双排风结构，可分别调整排风大小。配进口德威尔压差表。
10	易拉门	设备前后为易拉门设计，前门设有 PC 观察窗。
11	计时功能	配备计时装置。
12	控制系统	位于设备后上方，包含电源，温度控制，计时，旋转，流量和排风检测等功能。 根据需要，客户可选配触摸屏 PLC 集成控制系统，程序内置，可自动控制设备的运转和工艺运行
13	气路	铁氟龙，配有防回流装置。
14	连锁装置	腔体上盖未盖上，工艺无法操作，避免误操作。
15	安全考虑	多项设计保证设备运转和操作安全。
16	动力条件	220V/1.0KW/N2/EXHAUST

### 工艺应用描述

1	工艺种类	MEMS release 和 Metallization for Si wafer
2	工艺应用	半导体 / MEMS
3	晶圆尺寸	6inch 及以下尺寸晶圆。
4	生产能力	单片操作或小尺寸多样片操作。
5	操作程序	放入样片，改好上盖。进行以下程序操作： 第一步：开启“SPPED”开关。 第二步：打开“N2 PURGE”开关，并调整排风。 第三步：关闭“N2 PURGE”开关，打开“HF GAS”开关。并调整排风。 第四步：关闭“HF GAS”开关。打开“N2 PURGE”开关，并调整排风。 第五步：关闭“N2 PURGE”开关。打开上盖，取出硅片。
6	工艺条件	典型工艺条件：转速 15rpm；N2 PURGE 30L/MIN，6min；HF GAS 9L/MIN。  排风和温度可根据需要调整。
7	工艺结果	腐蚀速率：50-300A/MIN， 外观：表面洁净，无腐蚀异点

### 联系方式

对设备和工艺如有任何问题和建议，请联系我们，我们将为您提供更详细咨询和服务。

联系人：高先生

邮箱：[mst168@126.com](mailto:mst168@126.com)

电话：0755 22303270

手机：13699877985